产品规格承认书

| 产品类型: SMD 3.2X2.5 普通晶体谐振器 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| _产品频率:12.000MHz | | | | | | |
| JY P/N: _ JYXT32S4-012.00000-9FE4C0 | | | | | | |
| 客户 P/N: | | | | | | |
| 客户编码/回签: | | | | | | |
| 核准: 审查: 编制: JLL | | | | | | |



广州晶优电子科技有限公司

Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd.

| 版本号 | 更新日期 | 更新描述 | 备注 |
|-----|-----------|------|----|
| V1 | 2019/7/30 | 首次 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | l | | |

产品规格

1. 产品特点

- ▶ 小型、超薄式表面贴装
- ▶ 宽温度、高稳定特性、高可靠信赖

2. 概要

| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|------|--------|-----|--------|------------|---------|
| 输出频率 | 12.000 | | 12.000 | | |
| 工作温度 | -40 | +85 | | $^{\circ}$ | 恒温高低温设备 |
| 存储温度 | -55 | | +125 | °C | |
| 负载 | 20 | | PF | 电容性负载 | |

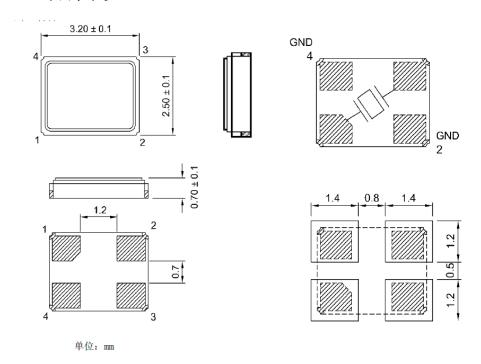
注: 仪器可采用等同 250B 的测试设备;

在测量频率公差特性值时需在温度稳定的常温环境 25±2℃下进行测试。

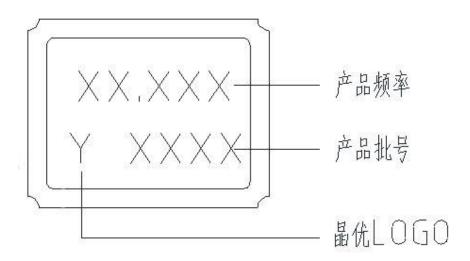
3. 频率与电性能

| | 参数 | 标示 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|----|--------|-----------|------------|-----|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 输出频率 | FL | 12.000 | | | MHz | |
| 2 | 振荡模式 | ОТ | AT 切,基频 | | | _ | |
| 3 | 负载电容 | CL | | 20 | | pf | |
| 4 | 频率公差 | ΔF/F | | ±10 |) ppm | | 25±2°C |
| 5 | 频率温度特性 | ΔF/F | ±25 | | +25 I nnm | | 工作温度范围 (ref. 25℃) |
| 6 | 工作温度范围 | T_OPR | -40 +85 | | ${\mathbb C}$ | | |
| 7 | 储存温度范围 | T_{STR} | -55 — +125 | | $^{\circ}$ | | |
| 8 | 静态电容 | CO | 7 | | pf | | |
| 9 | 等效电阻 | Rr | <u> </u> | | Ω | | |
| 10 | 驱动电平 | DL | | | uW | | |
| 11 | 绝缘电阻 | IR | 500 — — | | МΩ | DC 100V | |
| 12 | 年老化 | Fag | ±3 | | ppm | 1 st year | |

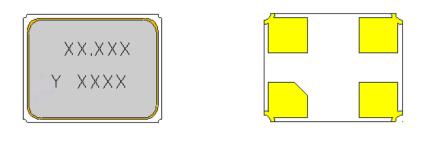
4. 外形尺寸

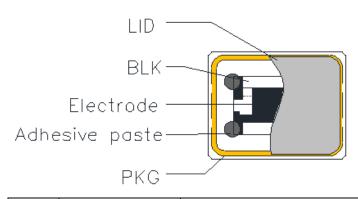


5. 产品印字



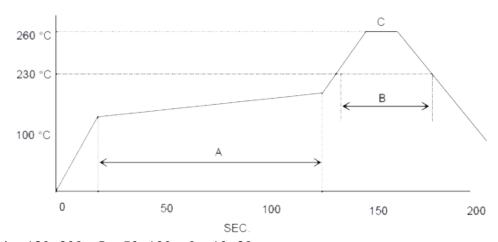
6. 结构及材料





| 序号 | 部件 | 材料 | 备注 |
|----|-----------|---|------|
| 1 | LID | KOVAR (Fe+Co+Ni | 平盖 |
| 2 | BLK | SiO ₂ (Quartz) | 石英晶片 |
| 3 | Electrode | Ag plating | 电极 |
| 4 | Adhesive | Ag/Silicon | 银胶 |
| 5 | PKG | AL ₂ O ₃ + Au plating | 基座 |

7. 回流焊测试

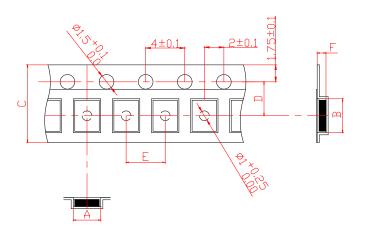


A: 120±20S; B: 50±10S; C: 10±2S

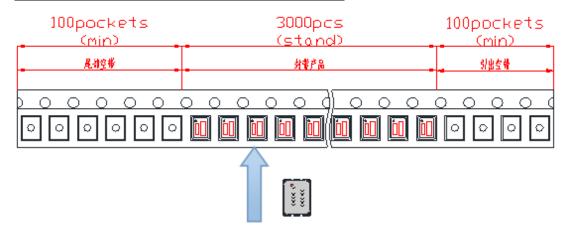
8. 可靠性测试条件(RELIABILITY TEST)

| 序号 | 项目 | 条件 | 参考标准 |
|----|------------------------------|---|----------------------------|
| No | Item | Conditions | Reference SPEC. |
| 1. | 跌落 Drop | 100cm 高处自由跌落到 3cm 厚木板上,3 次 High: 100cm;Thickness:3cm;3times | IEC68-2-32. Ed |
| 2. | 振动 Vibration | 频率 Frequency:10~55Hz: 幅度 Amplitude:± 1.5mm 频率 Frequency:55~500Hz:加速度幅度 acceleration rate:200m/ S² 周期 Cycle time:10-500-10Hz: 11min 振动方向 Direction:X, Y, Z | GJB360. 201 GJB360. 204 |
| 3. | 温度变化 Temperature shock | -40℃±2℃(30min) ←→85℃±2℃(30min);循环 10次 -40℃±2℃(30min) ←→85℃±2℃(30min);For 10 cycles | IEC68-2-14. N |
| 4. | 湿热 Humidity | 温度: 40℃±2℃; 湿度 90-95%; 时间:96 小时 Temp:40℃±2℃; Humidity: 90-95%; Time:96h | GJB360. 103 |
| 5. | 低温 Cold resistance | 温度: -40℃±2℃; 时间:96 小时 Temp:-40℃±2℃; Time:96h | IEC68-2-1. A |
| 6. | 高温 Heat resistance | 温度: 100℃±2℃; 时间:96 小时 Temp:100℃±2℃; Time:96h | IEC68-2-2. B |
| 7. | 回流焊 Reflow | 260 °C 230 °C 100 °C A 100 °C A 120±20S; B: 50±10S; C: 10±2S | IEC68–2–58. Td |
| 8 | 老化 Aging | 温度: 125℃;时间: 48 小时 Temp: 125℃; Time:48h | JY. Method |
| 9 | 气密性 Leakage | 氦气 (0.40.6MPa):2小时 He(0.40.6MPa):2h | IEC 68-2-17.Q |
| 10 | 可焊性 Solderability | 温度: 235℃±5℃ Temp:235℃±5℃ | IEC68-2-58. Td |

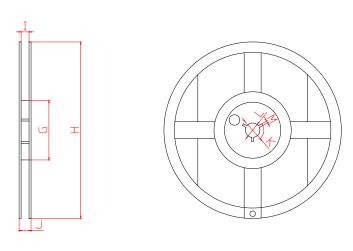
9. 编带



| Α | A B | | C D | | F |
|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 2.8±0.1 | 3.5±0.1 | 8.0±0.2 | 3.5±0.05 | 4.0±0.1 | 0.95±0.1 |

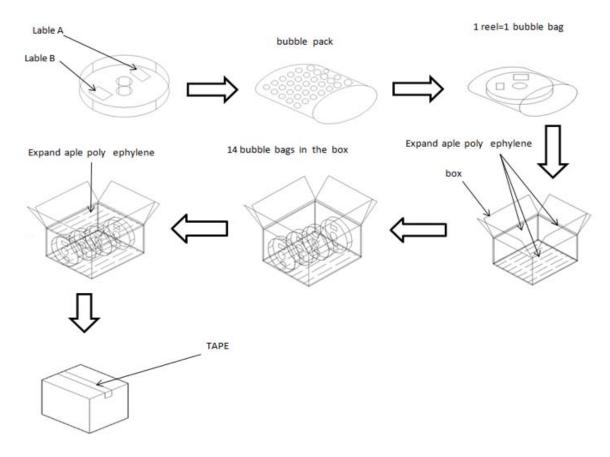


10. 卷盘



| G | Н | I | J | K | L | M |
|---------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Ф60±1.0 | Ф178±1.0 | 8.5±0.5 | 10.5±0.5 | 22.5±0.5 | 13.5±0.5 | 3.0±0.5 |

11. 包装与标识



Label A



Label B



注:

- 1. 包装运输过程中不可撞击;
- 2. 包装后不能放置接触到水的环境,
- 3. 保存于洁净及无腐蚀的气体环境中;
- 4. 请在6个月时间内使用产品;
- 5. 保存环境在温度环境-10℃~40℃,湿度低于75%。